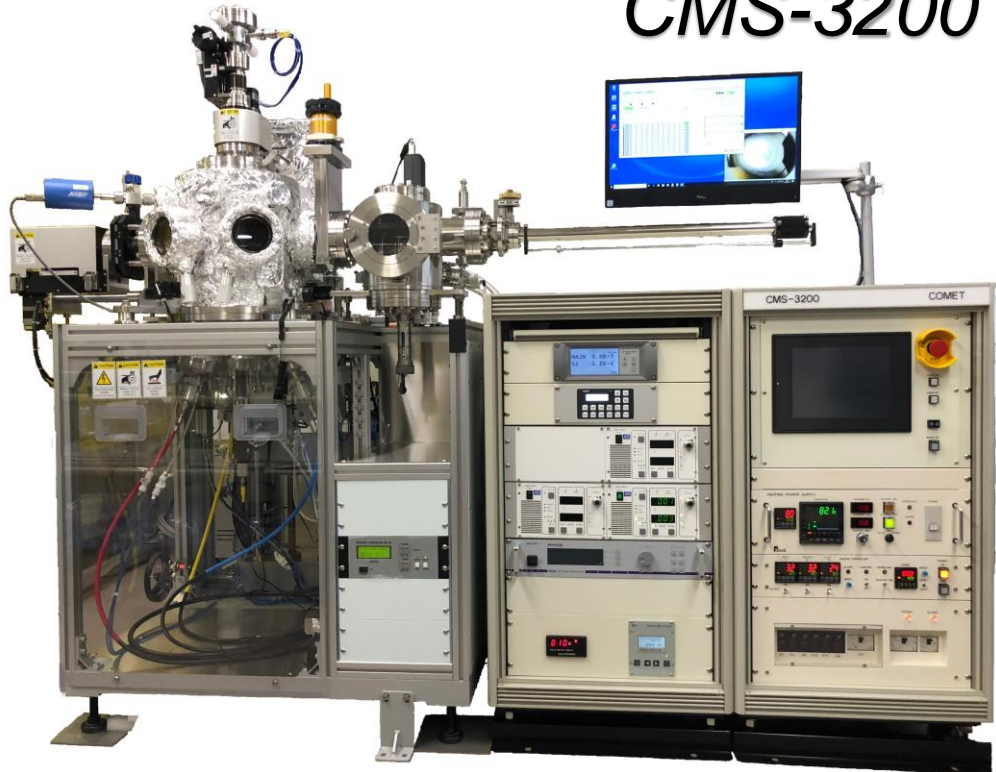


# Combinatorial Sputtering System CMS-3200

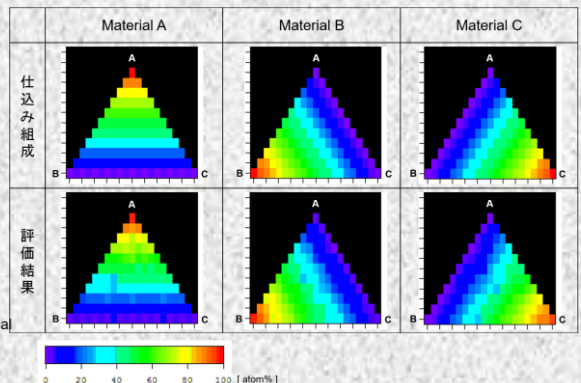
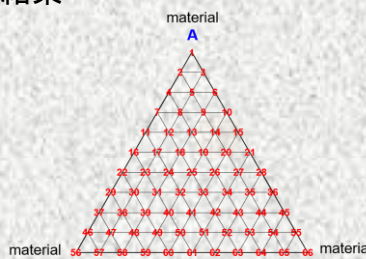


## CMS-3200の特徴

- 2元・3元のコンビナトリアル組成傾斜成膜に対応  
有効成膜エリア： 1辺 25 mmの正三角形
- 2インチ・マグネロン・スパッタカソード 3基搭載
- RF・DC電源を各3組最大6基搭載可能
- LabView によるレシピ編集と全自動コンビナトリアル成膜

## コンビ成膜の特長： 単一基板に数100条件の組成分布を形成

3元コンビ組成傾斜試料の  
仕込み組成とXRF分析結果

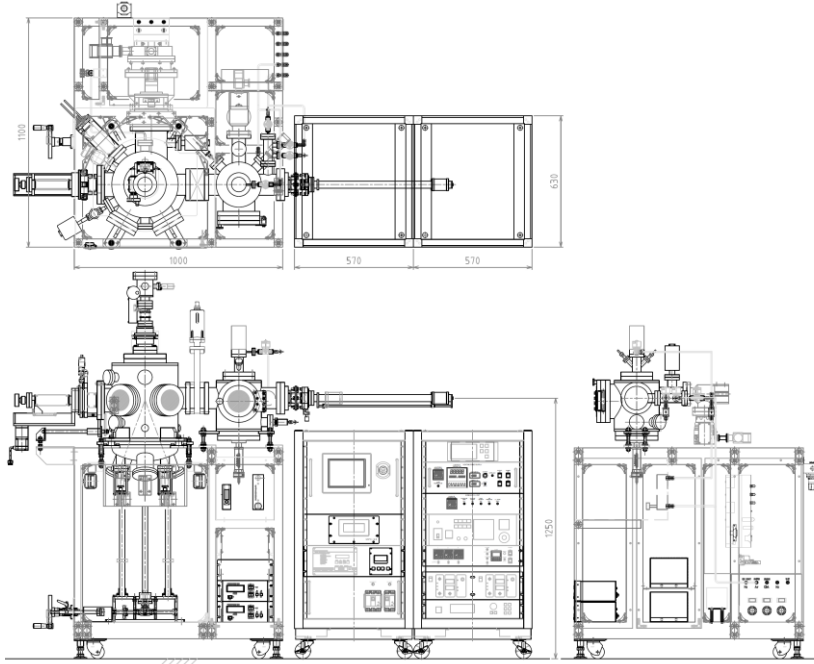


## ◆アウトソースプロセスエンジニアリングのご提案

PLD法では実現しにくかった成膜面積の拡大を図るべく、コンビナトリアル・マグネトロンスパッタシステム、CMS-3200は開発されました。有効エリアは1辺25mmの正三角形。2インチウエハを標準基板とするため、パターン描画・エッチングなどのライン後工程に投入でき、成膜のみならず解析までをハイスループット化できます。

CMS-3200は同型機が弊社のラボに常設されており、コンビ薄膜ライブラリの蓄積と受託成膜によるフィージビリティスタディサポートを行なっています。装置購入前に弊社に成膜委託をご依頼いただければ、装置導入時に直ちに有望な組成比率にフォーカスして研究開発をスタートできます。

### ◆外観図



### ◆CMS-3200基本仕様

- ・ 2"マトリクス用スパッタガン 3基
- ・ 強磁性体用スパッタ・カソード
- ・ 2"ウエハカセットロードロックシステム
- ・ 25 mm/辺の3元コンビ試料の作成
- ・ 3元組成傾斜成膜対応マスク・システム
- ・ Co-sputtering成膜に対応
- ・ 自動圧力制御
- ・ プロセスパラメーターロギング機能
- ・ 基板加熱成膜対応 (650°C以上)
- ・ TMP/Cryo-Pumpを用いたクリーンバキューム仕様
- ・ DC・RF電源を任意選択可能 (金属, 酸化物, 窒化物 etc)
- ・ 使いやすいGUIのプロセスマネージャー